

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的發展戰略」。

[編纂]

假設[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)及假設[編纂]未獲行使，經扣除估計[編纂]及我們就[編纂]應付的其他估計[編纂]開支，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]百萬港元。

我們擬將上述[編纂]用作以下用途：

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，預計將用於增加我們的研發投資，以推動持續創新並支持我們在主要應用場景(即工業成像、科學成像、專業影像及醫療成像解決方案)的持續研發及產品迭代。我們的研發重點將聚焦於持續優化像素設計及電路架構，以打造突破量子效率、讀取速度及動態範圍等性能參數邊界的新一代產品。我們的投資將主要用於採購額外的研發設備(包括晶圓探針、光電測試儀器、電子顯微鏡、3D測量儀器、量子效率測試儀器、高低溫試驗箱)、IT硬件及軟件(包括IT服務器、存儲系統、數據備份系統、不間斷電源(UPS)及監視器)、晶圓掩膜版、玻璃模具及陶瓷模具、優化IT基礎設施及系統、支持驗證及可靠性測試以及維持研發及相關人力資源。我們致力於為現有及不斷發展的應用場景分配更多資源支持。於往績記錄期間，我們主要專注於工業成像及科學儀器，並已贏得廣泛的市場及客戶認可。展望未來，除了進一步鞏固我們在這兩個應用場景的地位外，我們還將在未來五年加速向醫療成像及專業影像領域擴張，這些領域帶來更高的技術挑戰，並需要更大的研發投入。具體而言，針對我們的各主要應用場景：
 - i. 工業成像：依托我們的全局快門像素、TDI像素、HDR技術及高速讀出電路等核心技術，我們計劃投入[編纂]%(或[編纂]百萬港元)，用於在該應用場景下開發並實現若干新產品的商業化，這些產品將在新能源、半導體及PCB/FPD板檢測領域有不同應用。我們計劃圍繞全局快門像素、高速讀出電路、3D成像傳感器、TDI圖像傳感器等核心技術進行高級迭代升級。我們的目標是開發一系列CMOS圖像傳感器，其將具有高快門效率(捕捉快速移動物體的清晰圖像)、大滿井容量(防止強光條件下像素飽和)、低噪聲水平(增強圖像清晰度)及高幀率(支持實時檢測)，從而為工業成像應用提供更準確及高效的視覺解決方案，如LCD面板的缺陷檢測、光伏晶圓的裂紋識別、鋰電池電極的紋理分析及半導體顆粒檢測。
 - ii. 科學成像：基於我們的BSI傳感器、HDR像素及低噪聲電路等核心技術，我們計劃投入[編纂]%(或[編纂]百萬港元)，用於在該應用場景下開發並實現若干新產品的商業化，這些產品將應用於生命科學、天文觀測、光譜分

未來計劃及[編纂]

析及顯微鏡領域。我們計劃圍繞高靈敏度像素、寬動態範圍像素、高動態電路、低噪聲電路及背照式圖像傳感器等核心技術進行高級迭代升級。我們旨在開發一系列CMOS圖像傳感器，其將具有寬光譜響應(覆蓋廣泛的波長範圍)、高量子效率(增強光信號轉換)、低噪聲性能(確保檢測微弱信號的準確性)、高幀率及大滿井容量，從而為生命科學顯微鏡、深空探測及光譜儀分析的應用提供更可靠的成像解決方案。

- iii. **專業影像**：利用捲簾快門像素、高速讀出電路、HDR像素技術及低噪聲電路等核心技術，我們計劃投入[編纂]%(或[編纂]百萬港元)，用於針對單反、視頻及廣播領域應用場景下開發並實現若干全新全畫幅及APS-C畫幅產品的商業化。我們計劃圍繞高動態像素、高動態電路、高性能ADC、3D堆疊圖像傳感器等核心技術進行先進迭代升級。我們的目標是開發一系列新的高端全畫幅及APS-C CMOS圖像傳感器。這些新產品不僅支持8K超高清分辨率，還具有高量子效率(增強弱光性能)、低噪聲(保留精細圖像細節)、高幀率(捕捉快速移動的場景)及大滿井容量(改善高光細節)，為單反、無反光鏡相機、專業影像以及無人機成像設備提供高質量的成像能力，從而滿足專業創作者對卓越圖像質量的追求。
- iv. **醫療成像**：依托高靈敏度像素及低噪聲電路等核心技術，我們計劃投入[編纂]%(或[編纂]百萬港元)，以開發及實現專注於CT與X射線設備的若干款新產品的商業化。我們計劃優化及升級高靈敏度像素、低噪聲電路、背照式圖像傳感器及3D堆疊圖像傳感器等核心技術，開發一系列專用CMOS圖像傳感器。這些新產品將集成高量子效率(增強微弱光信號的檢測)、低噪聲(確保圖像清晰度)、高幀率(實現動態生理過程的實時可視化)及大滿井容量。這些新產品將為醫療應用提供更清晰、更可靠的成像數據，例如用於體內顯微成像的一次性內窺鏡及醫學X射線成像中的精確病變可視化，從而提高臨床診斷的準確性及效率。醫療成像是我們新的戰略增長領域。

我們計劃在未來五年內，於上述四大應用場景中開發19款新的CMOS圖像傳感器產品，並完成四個像素開發項目。為支持此等發展，我們計劃涉及合共555名不同資歷的現任及新任研發人員(以人年計)，全部擁有碩士或更高學位，工作經驗從零到七年以上不等；預計未來五年的薪酬總額(包括基本工資、社會保險及住房公積金)約為人民幣[編纂]百萬元。就銷售及管理職能而言，我們計劃涉及合共125名不同資歷的現任及新任人員(以人年計)，全部持有本科或以上學歷，並擁有零至八年以上的工作經驗；預

未來計劃及[編纂]

計未來五年的薪酬總額(包括基本工資、社會保險及住房公積金)約為人民幣[編纂]百萬元。具體而言，我們計劃分別於2026年、2027年及2028年招聘47名、56名及19名額外的研發人員，以及10名、16名及7名額外的銷售及管理人員。銷售人員將負責制定初步產品概念，並在試產期間提供市場反饋以完善產品規格；研發人員將(i)承擔整個傳感器研發流程，包括電路、模擬及佈局設計、系統軟件設計、測試與驗證、可靠性測試及技術規格編製；及(ii)專注於像素結構及晶圓製程的設計與優化，以及光電性能測試；而管理人員則將負責與各項目相關的行政、財務及人力資源管理。

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，預計將用於建立一個先進的CMOS圖像傳感器研發中心，包括(i)購置並維護一棟辦公樓，作為我們的研發创新中心及區域總部；(ii)該場地的設計與翻新，以滿足先進半導體研究的要求；(iii)採購並安裝研發設備、測試儀器及配套基礎設施；及(iv)建立研發及相關團隊。該新研發中心將通過我們的杭州附屬公司作為南方區域中心設立，旨在擴展我們此前集中於長春總部的傳感器研發、測試及存儲功能。它還將提供數據及設施的雙重備份，以提高運營安全性，並確保業務在潛在干擾下的連續性。新研發中心將聚焦於高性能像素架構及先進技術，例如基於InGaAs材料的短波紅外圖像傳感器，從而擴展我們的技術範圍並加速下一代CMOS圖像傳感器的商業化。憑藉杭州雄厚的產業及人才資源，該研發中心將促進與供應鏈夥伴更緊密的合作，提升研究效率，並有助吸引高素質的專業人士以支持我們的長期增長。董事認為，收購辦公樓而非租賃在商業上更為合理，原因為：(i)擴大的自建潔淨室設施將使我們能夠滿足更廣泛的研發需求及提升我們的技術；(ii)擴大自建像素及驗證平台將加強我們的平台開發及提高技術壁壘；(iii)擁有該物業以保護我們免受未來租金上漲的影響；(iv)可設立陳列室，展示我們的產品設計過程及成果，為技術交流、產品驗證及客戶互動提供平台，進一步提升我們的市場佔有率及品牌影響力；及(v)有助吸引頂尖人才及提高員工滿意度。

為支持先進CMOS圖像傳感器研發中心的設立，我們計劃在未來五年內總共投入142名現有及新增研發人員(以人年計)及28名現有及新增管理人員(以人年計)。具體而言，我們計劃分別於2026年、2027年、2028年及2029年招聘13名、6名、21名及2名額外的研發人員，以及2名、2名、2名及1名額外的管理人員。新聘人員對於確保研發中心的有效運作至關重要；研發人員將負責產品設計、驗證與測試，構成推動技術創新的核心團隊，以及進行像素與晶圓製程設計並建立新製程平台，這對於開發下一代CMOS圖像傳感器產品至關重要；而管理及行政人員則將負責監督中心的行政、財務及人力資源職能，以確保各項運作協調順暢且合規。

於2026年2月28日，杭州辰芯與杭州高新技術產業開發區資產經營有限公司(「賣方」)訂立資產收購協議，據此，杭州辰芯同意收購而賣方同意出售(其中包括)位於杭州的總建築面積約為3,856平方米的一幢建築物(「該物業」)，代價為人

未來計劃及[編纂]

民幣48.7百萬元。該物業將用於建立一個先進的CMOS圖像傳感器研發中心，而[編纂]的部分[編纂]將用於結付上述收購的代價。

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，預計用於擴展我們的封裝及測試生產線，包括(i)就擴建潔淨室設施建立額外的封裝設施，以滿足先進製造需求；(ii)採購及安裝封裝及測試設備，以提升產能及品控；及(iii)調配、招聘及培訓技術人員，以支援擴展後的營運。隨著我們的封裝產品質量、準時交付率及組裝良率持續提升，我們計劃進一步擴大內部產能，以加強供應鏈安全、提高生產可控性並增強我們對運營風險的韌性。此外，擴大的產能將使我們能夠通過內部封裝作業實現降本增效，並以更快的上市時間和更具競爭力的產品更好地服務客戶，這預計將提升我們的整體盈利能力。通過進一步整合產業鏈內的上下游生產流程，我們旨在鞏固我們的核心競爭優勢並強化我們的長期戰略定位。於往績記錄期間，我們的內部封裝產能分別約為每月25,000件。新封裝生產線預計將於2026年或2027年竣工，使我們的產能每月增加至55,000件。

對於設備採購，我們將根據我們的具體需求及技術要求獲取及比較報價，並在使用前對設備進行測試及檢查。對於工廠改造，我們將根據我們的具體需求設計佈局方案、獲取及比較報價、進行改造及進行最終檢查。

我們擬採購一系列用於芯片貼裝、引線鍵合、玻璃鍵合、過程中檢測及晶圓減薄的封裝及測試設備，預期可使用年期為五至十年。我們目前使用類似的設備進行芯片貼裝、引線鍵合、玻璃鍵合及過程中檢測，其剩餘使用壽命為四至九年；然而，我們沒有類似的晶圓減薄設備。

為確保在產能擴張的同時實現高效、可靠及高質量的運營，我們計劃於2026年招聘約12名額外的生產操作員，並在之後的未來五年內每年增聘三至六名，以應對增加的封裝、測試及檢驗工作。我們還將通過組建一個由工程師及技術人員組成的專責管理團隊來加強設施支持，於2026年增聘約4名設施支持人員，並在此後每年增聘三至四名，以確保公用設施及潔淨室系統的穩定運行。此外，我們將於2026年增聘約3名研發人員，並在未來五年內每年增聘二至四名，以提供製程工程支持、優化量產製程、提高良率並促進新技術引入。

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，預計用於通過戰略性地域擴張，增強我們的海外運營，包括(i)在香港成立新附屬公司及為新辦公室招聘人員；(ii)擴大銷售團隊以支持我們的海外銷售及營銷工作，並擴大我們的全球業務版圖(包括香港、韓國及日本)；(iii)增加參與國際行業活動及貿易展覽；及(iv)擴大海外研發布局。我們預計該等舉措將擴大我們的客戶網絡並鞏固我們在CMOS圖像傳感器行業的市場地位，從而夯實自身地位、推動收入增長並提升我們的全球市場佔有率。我們的董事認為，且聯席保薦人同意，我們的海外擴張計劃是可行的，原因是(i)

未來計劃及[編纂]

新的香港附屬公司將簡化海外銷售收款、結算及供應鏈付款，降低匯率風險並提升物流效率。其亦將作為一個平台，吸引來自香港及海外具備技能的研發、銷售及管理人才，以支持我們的技術發展及海外擴張。於最後實際可行日期，我們已為其香港附屬公司完成相關境外直接投資備案；(ii)於往績記錄期間，來自韓國及日本的銷售額佔我們海外收入約20%至35%，且我們擬繼續擴大其在該等亞洲市場的銷售力度；及(iii)鑒於專業攝影及攝像(P&V)客戶主要位於日本，我們計劃通過招聘經驗豐富的P&V工程師，進一步加強我們在日本的研發佈局，以提升我們的技術能力及對客戶需求的響應速度。

為支持海外擴張，我們計劃在未來五年內逐步將海外銷售團隊擴充至約7至18名人員，每年增聘2至4名銷售人員，以增強客戶覆蓋及本地服務能力。此外，我們計劃部署約三名管理人員，負責海外業務活動的日常行政、財務及營運管理。

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，預計用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]的中位數，上述[編纂][編纂]的分配將按比例調整。

除了與購置辦公大樓、購買設備及額外折舊相關的現金流出外，經作出一切合理查詢後且就彼等所深知及確信，我們董事認為該實施計劃不會對我們的成本結構、毛利率及風險狀況造成重大改變。

假設[編纂]未獲行使，倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元(指示性範圍的上限)，扣除[編纂]費用、佣金以及估計開支後，[編纂][編纂]預計約為[編纂]百萬港元且倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元(指示性範圍的下限)，所得款項約為[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取額外[編纂]約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]的下限)至[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]的上限)。倘[編纂]獲行使，我們擬按比例將額外[編纂]用於上述用途。

倘我們的[編纂]不足以撥付上述用途，我們擬透過多種方式籌集餘額，包括營運產生的現金、銀行貸款及其他借款。倘[編纂][編纂]未即時應用於上述用途，我們僅會將該等[編纂]入持牌商業銀行；及／或證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律及法規所界定的其他獲授權金融機構。倘上述擬議的[編纂]出現任何變動，我們將發出適當公告。

未來計劃及[編纂]

下表載列我們[編纂]計劃用途的預期實施時間表：

	分配比例	截至12月31日止年度					總計
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
	(%)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)
加大研發投入，推動持續創新，							
支持主要應用場景的產品迭代	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
i. 工業成像.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
ii. 科學成像.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
iii. 專業影像.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
iv. 醫療成像.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
建立先進CMOS圖像傳感器							
研發中心.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴展我們的封裝及測試生產線，							
以增強我們的能力.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
通過戰略性地理擴張增強我們的							
海外運營.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及一般企業用途.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>100.0</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>